



2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2021年4月27日
上場取引所 東

上場会社名	新光電気工業株式会社		
コード番号	6967	URL	https://www.shinko.co.jp
代表者	(役職名) 代表取締役社長	(氏名)	藤田 正美
問合せ先責任者	(役職名) 経営企画室長	(氏名)	清野 貴博
定時株主総会開催予定日	2021年6月25日	配当支払開始予定日	2021年6月28日
有価証券報告書提出予定日	2021年6月28日		
決算補足説明資料作成の有無	: 無		
決算説明会開催の有無	: 無		

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期の連結業績(2020年4月1日～2021年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期	188,059	26.8	23,328	622.7	26,507	450.7	18,018	569.7
2020年3月期	148,332	4.3	3,227	△33.4	4,813	△37.1	2,690	6.5

(注) 包括利益 2021年3月期 19,112百万円 (941.7%) 2020年3月期 1,834百万円 (△77.0%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2021年3月期	133.38	—	12.4	11.9	12.4
2020年3月期	19.92	—	1.9	2.5	2.2

(参考) 持分法投資損益 2021年3月期 ー百万円 2020年3月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年3月期	240,977	153,393	63.7	1,135.49
2020年3月期	203,979	137,658	67.5	1,019.01

(参考) 自己資本 2021年3月期 153,393百万円 2020年3月期 137,658百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2021年3月期	33,801	△32,148	538	42,508
2020年3月期	12,696	△35,591	16,939	40,046

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2020年3月期	—	12.50	—	12.50	25.00	3,377	125.5	2.4
2021年3月期	—	12.50	—	17.50	30.00	4,052	22.5	2.8
2022年3月期(予想)	—	17.50	—	17.50	35.00		20.3	

(注) 2021年3月期期末配当金の内訳 普通配当15円 特別配当 2円50銭

3. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日～2022年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	108,900	—	18,000	—	18,100	—	12,600	—	93.27
通 期	227,300	—	33,400	—	33,700	—	23,300	—	172.48

(注) 2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用するため、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載していません。

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動): 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料14ページ「4. 連結財務諸表および主な注記(5) 連結財務諸表に関する注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

2021年3月期	135,171,942株	2020年3月期	135,171,942株
2021年3月期	81,928株	2020年3月期	81,848株
2021年3月期	135,090,082株	2020年3月期	135,090,094株

(参考) 個別業績の概要

1. 2021年3月期の個別業績(2020年4月1日～2021年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期	180,412	26.3	22,235	515.9	26,115	370.7	17,905	408.8
2020年3月期	142,823	5.0	3,610	△29.2	5,547	△35.4	3,519	△1.5

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2021年3月期	132.55	—
2020年3月期	26.05	—

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円 銭		
2021年3月期	238,587		152,742		64.0	1,130.67		
2020年3月期	201,867		138,480		68.6	1,025.09		

(参考) 自己資本 2021年3月期 152,742百万円 2020年3月期 138,480百万円

※ 決算短信は公認会計士または監査法人の監査の対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況(1) 当期の経営成績の概況 ② 今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	4
(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当	4
2. 経営方針	5
(1) 経営の基本方針	5
(2) 中長期的な経営戦略	5
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	6
4. 連結財務諸表および主な注記	7
(1) 連結貸借対照表	7
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	9
連結損益計算書	9
連結包括利益計算書	10
(3) 連結株主資本等変動計算書	11
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	13
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	14
(継続企業の前提に関する注記)	14
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)	14
(セグメント情報)	16
(1株当たり情報)	18
(重要な後発事象)	18
参考資料	19

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

① 当期の経営成績

当期の経済環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大が社会・経済に大きな影響をもたらし、日本におきましては、度重なる緊急事態宣言の発令等により、経済活動は大きな制約を受け、個人消費の低迷が続くなど、厳しい状況のまま推移しました。海外におきましても、世界各国において経済活動の大幅な縮小を余儀なくされ、期後半以降、中国、米国等においては景気回復の動きが見られましたが、依然として先行き不透明な状況が継続しました。

半導体業界につきましては、期前半において新型コロナウイルス感染拡大による自動車・スマートフォン等の需要減退の影響を受けたものの、テレワーク、オンライン学習の拡大ならびに第5世代移動通信システム(5G)の実用化などを背景として、データセンター用のサーバー向けの需要が増加するとともに、パソコン向けも好調に推移しました。さらに、期後半にかけて自動車市場向けが回復に転じるなど、半導体需要の拡大傾向が鮮明となりました。

このような環境下において、当社グループにおきましては、全社において新型コロナウイルスの感染防止対策を継続的に実施し、ICT(情報通信技術)社会に欠かすことのできない半導体サプライチェーンの一翼を担う企業として、お客様への製品の安定的な提供等、事業活動の継続に努めてまいりました。主力のフリップチップタイプパッケージについては、高性能半導体の需要拡大に対応すべく、2018年度より大型設備投資を展開しており、当期において高丘工場(長野県中野市)で新ラインが量産を開始するなど、引き続き生産体制増強に注力いたしました。また、今後需要拡大が見込まれる先端メモリー、半導体製造装置市場などの成長分野向けに重点的に経営資源を投下いたしました。さらに、競争が激化する市場環境にあつて、収益力・競争力の一層の強化をはかるべく、生産性・品質向上等の取り組みを強化いたしました。

それらの結果、フリップチップタイプパッケージは、パソコン向けおよびデータセンター用のサーバー向けなどで受注が大幅に増加するとともに、旺盛な需要のもと、昨年10月から新ラインが量産を開始し、生産能力が拡充されたことにより、売上増加に寄与しました。半導体製造装置用のセラミック静電チャックは、好調な市場環境を背景に需要が大幅に拡大し、プラスチックBGA基板は新ラインの稼働開始などにより、先端メモリー向けに売上が増加しました。また、リードフレームは、第3四半期に入って底打ちした自動車向けの売上が、その後さらに大きく回復したことなどにより、増収となりました。これらにより、当期の連結売上高は1,880億59百万円(対前期比26.8%増)と大きく増加しました。

収益面につきましては、生産能力増強などによる高付加価値製品等の増加および収益性向上などにより、経常利益は265億7百万円(対前期比450.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は180億18百万円(同569.7%増)となり、売上・収益とも大幅な増収増益となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

プラスチックパッケージ

フリップチップタイプパッケージは、テレワークやオンライン学習の拡大などにより、パソコン向けおよびサーバー向けに受注が大幅に増加し、高丘工場における新ラインの量産開始が増収に寄与するとともに、プラスチックBGA基板は、一層の小型・薄型化のニーズに対応する新ラ

インの稼働開始などにより、先端メモリー向けに売上が大きく増加しました。I C組立は、ハイエンドスマートフォン向けの需要が拡大したことにより、増収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は1,133億33百万円(対前期比38.9%増)となりました。

メタルパッケージ

セラミック静電チャックは、半導体製造装置市場における旺盛な需要を背景に受注が大幅に拡大し、リードフレームは、増産対応をはかっていたQFNタイプが幅広い用途向けに売上が増加するとともに、第3四半期に入って底打ちした自動車向けの売上が、その後さらに大きく回復したことなどにより、増収となりました。CPU向けヒートスプレッダーは、サーバー向けが堅調なまま推移したものの、パソコン向けの需要が減少し、ガラス端子は第3四半期において回復傾向を示しましたが、期前半において光学機器向けが低調に推移したことなどにより、減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は664億2百万円(対前期比10.9%増)となりました。

② 今後の見通し

今後の経済環境は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の進展や各国政府の経済支援策等により、先進国を中心として景気が回復基調で推移することが期待されるものの、感染症の影響長期化や米中貿易摩擦の影響が引き続き懸念されるなど、依然として楽観が許されない状況が継続することが見込まれます。日本におきましても、新型コロナウイルス感染症による経済活動への制約が長期化し、個人消費低迷が継続することも想定されるなど、先行き不透明な状況が続くものと思われまます。

半導体業界におきましては、第5世代移動通信システム(5G)の実用化やIoT・AIの活用の進展ならびにEV(電気自動車)、自動運転等の技術開発が加速する自動車向けなど、半導体需要は中長期的に大きく増加することが見込まれます。また、テレワークやオンライン学習をはじめとする社会のデジタル化の動きが今後さらに加速・進展することにより、幅広い分野において半導体は用途を広げ、市場はさらに拡大するものと想定されます。一方で、一層の高機能化・高速化のニーズとともに、省電力化への対応がさらに求められるなど、高度化する市場ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が一段と激化することが見込まれます。

このような環境下にあつて、当社グループにおきましては、引き続き高い成長が見込まれる市場向けに重点的に経営資源を投下し、今後の発展を目指してまいります。サーバー、パソコン等に搭載される高性能半導体向けに、一層の需要拡大が見込まれるフリップチップタイプパッケージについては、高丘工場(長野県中野市)等における大型設備投資について旺盛な需要に対応すべく着実に生産能力の増強をはかっています。また、半導体需要の増大を背景に中長期的な受注拡大が想定される半導体製造装置向けのセラミック静電チャックの生産能力拡充ならびに半導体メモリーの高速化・大容量化に対応するプラスチックBGA基板の一層の拡販に努めるなど、今後の市場拡大を的確に捉え、半導体の高性能化に寄与する当社製品のさらなる販売拡大を目指してまいります。

加えて、収益基盤の一層の強化をはかるべく、これまで培ってまいりました多様な半導体実装技術をもとに、市場ニーズの高度化に対応し、高い競争力を持つ製品の開発・商品化に取り組む

とともに、開発・設計から生産に至るすべての段階において品質を造り込み、優れた製品を安定的に供給することができる生産体制の確立に努めてまいります。

当社グループは、引き続き成長が見込まれる半導体市場にあって、常にお客様のニーズを起点とし、機能・性能、コスト、品質すべてにおいてお客様にとって価値の高い製品・サービスを提供することにより、「限りなき発展」を果たしてまいり所存であります。

以上の状況をふまえ、次期の業績予想といたしましては、連結売上高 2,273 億円、連結経常利益 337 億円、親会社株主に帰属する当期純利益 233 億円を見込んでおります。なお、業績予想の前提となる為替レートは、1 米ドル=105 円 を想定しております。

(2) 当期の財政状態の概況

① 資産、負債および純資産の状況

当連結会計年度末における財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ総資産が 369 億 98 百万円増加し 2,409 億 77 百万円となりました。負債は 212 億 63 百万円増加し 875 億 84 百万円となりました。純資産は 157 億 34 百万円増加し 1,533 億 93 百万円となりました。この結果、自己資本比率は 63.7%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は 338 億 1 百万円（前年度比 211 億 5 百万円増）となりました。また、投資活動の結果使用した資金は 321 億 48 百万円（同 34 億 42 百万円減）となりました。財務活動の結果得られた資金は 5 億 38 百万円（同 164 億 1 百万円減）となりました。

これらの活動の結果に為替換算差額を加味した当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 24 億 62 百万円増加し 425 億 8 百万円となりました。

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重要施策の一つと考えており、半導体業界の急速な技術革新に対応した設備投資や研究開発投資を通じた強固な企業基盤の確立と将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実も考慮し、財政状態、利益水準および配当性向などを総合的に勘案した利益配当を行うことを基本方針としております。

当期における配当につきましては、上記の方針をふまえ総合的に判断した結果、期末配当は、株主の皆様のご支援にお応えするため、普通配当を2円50銭増配し15円とし、それに特別配当2円50銭を加え、前期に比べ5円増配の1株当たり17円50銭とし、中間配当の12円50銭とあわせて年間30円とさせていただきます。予定であります。

また、次期における配当につきましては、当期に比べ5円増配の1株当たり年間35円（中間配当17円50銭、期末配当17円50銭）とさせていただきます。予定であります。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は、人々の豊かな暮らしを支え、今後、中長期的な成長が見込まれるエレクトロニクス産業にあって、新たなテクノロジーの開発とその蓄積を原動力として、事業環境の変化に即応できる強靱な「ものづくり」を実現し、お客様のニーズを起点とする優れた製品を開発・製造・販売することによって、「限りなき発展」を目指しています。

また、このような「技術力」、「発展性」とともに、「国際性」、「温かさ」を企業理念として掲げ、世界各国のお客様と取引を行い、各地に拠点を展開するグローバル企業として国際社会での共存共栄を念頭に置き、多様な人材の能力を結集し、社員一人ひとりの成長を実現できる環境づくりに努め、「人と地球環境への温かさ」を考えた経営姿勢で事業を推進することにより、社会の健全な発展に寄与することを目指しています。

(2) 中長期的な経営戦略

第5世代移動通信システム(5G)の実用化等を背景とするビッグデータ、AIなどの活用の広がりが、経済や社会の仕組みに変化をもたらし、これまでとは次元の異なるイノベーションを生み出す可能性を秘めており、半導体は、その可能性を実現するキーテクノロジーとして革新を続けていくことが期待されています。また、自動運転、EV(電気自動車)等の技術開発が加速する自動車や急速な拡大が想定されるIoT関連市場、さらに、人々の健康を支える医療分野など、半導体は、今後も市場を拡大することが見込まれています。

一方で、高機能化・高速化等の技術革新および絶えず変化する市場ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が、さらに一段と激化することが予想されます。

このような産業にあって、当社グループは、半導体デバイスの優れた機能を人々の生活のなかへともたらずインターコネクトテクノロジーをベースに、高い競争力を持つ製品の開発とものづくりの革新に努め、お客様にとって、機能・性能、コスト、品質すべてにおいて価値の高い製品・サービスをご提供することにより、お客様の成功を支え、自らの発展・成長を目指してまいります。また、キャッシュ・フローを重視し、常に利益を創出できる強固な経営基盤の確立に努め、かつコーポレート・ガバナンスの充実をはかるとともに、以下の項目に重点をおいた経営戦略を展開してまいります。

① 成長分野への重点的展開

今後、市場拡大の一方で、高性能化・高機能化のニーズを背景にテクノロジーの高度化が見込まれる半導体産業にあって、お客様のニーズを的確にとらえ、それを実現する開発力・製造力の充実・革新に努めるとともに、創業以来培ってきたコアテクノロジーをもとに、高い成長が見込まれる分野に重点的に経営資源を投下し、強い競争力を有する製品の開発・量産化を推進することにより、さらなる成長を目指してまいります。

② 強固な生産体制の構築

市場環境の変化が激しく、熾烈な競争が繰り返される半導体産業にあつて、市場の変化に速やかに対応する強固な生産体制を構築することが企業存続・発展の条件ととらえ、全社において製造プロセスの革新と最適化を強力に推進いたします。また、開発・設計から生産に至るすべての段階において品質を造り込み、優れた製品を安定的に供給することができる体制を確立することにより、収益基盤の一層の強化をはかってまいります。

③ SHINKO Wayの推進

社会における新光電気グループの存在意義、大切にすべき価値観、および社員が実践すべき行動指針、守るべき行動規範を示した「SHINKO Way」の実践を通じ、株主の皆様のご期待に応え、お客様、お取引先、地域社会の皆様や社員をはじめとするステークホルダーの方々との調和をはかるとともに、美しい地球環境が次の世代へと受け継がれるよう、地球環境と企業活動の調和を基本理念とし、豊かな社会づくりに貢献することを目指してまいります。

3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性および企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、検討を進めていく方針であります。

4. 連結財務諸表および主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	40,557	42,940
受取手形及び売掛金	41,745	51,767
有価証券	125	116
商品及び製品	1,852	2,214
仕掛品	11,018	13,372
原材料及び貯蔵品	3,692	6,179
その他	5,670	7,949
貸倒引当金	△5	△6
流動資産合計	104,656	124,534
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	33,883	34,441
機械装置及び運搬具(純額)	20,264	32,278
工具、器具及び備品(純額)	1,930	1,896
土地	6,740	6,960
建設仮勘定	30,547	34,973
有形固定資産合計	93,365	110,551
無形固定資産	1,167	1,130
投資その他の資産		
投資有価証券	44	45
退職給付に係る資産	906	1,266
繰延税金資産	3,465	3,108
その他	380	356
貸倒引当金	△7	△16
投資その他の資産合計	4,789	4,761
固定資産合計	99,322	116,443
資産合計	203,979	240,977

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	23,464	29,544
短期借入金	21,000	25,000
未払金	8,235	10,655
未払法人税等	294	7,575
未払費用	7,682	8,999
その他	1,097	2,697
流動負債合計	61,774	84,471
固定負債		
退職給付に係る負債	3,649	2,572
その他	896	540
固定負債合計	4,546	3,112
負債合計	66,320	87,584
純資産の部		
株主資本		
資本金	24,223	24,223
資本剰余金	24,129	24,129
利益剰余金	94,312	108,953
自己株式	△92	△92
株主資本合計	142,572	157,213
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△0	0
繰延ヘッジ損益	21	△245
為替換算調整勘定	△2,308	△1,970
退職給付に係る調整累計額	△2,626	△1,604
その他の包括利益累計額合計	△4,914	△3,820
純資産合計	137,658	153,393
負債純資産合計	203,979	240,977

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売上高	148,332	188,059
売上原価	132,771	152,059
売上総利益	15,561	36,000
販売費及び一般管理費	12,333	12,671
営業利益	3,227	23,328
営業外収益		
受取利息	294	90
為替差益	831	2,569
雑収入	513	591
営業外収益合計	1,639	3,251
営業外費用		
支払利息	24	54
雑支出	29	18
営業外費用合計	54	72
経常利益	4,813	26,507
特別損失		
固定資産除却損	873	875
特別損失合計	873	875
税金等調整前当期純利益	3,940	25,631
法人税、住民税及び事業税	731	7,570
法人税等調整額	517	42
法人税等合計	1,249	7,612
当期純利益	2,690	18,018
親会社株主に帰属する当期純利益	2,690	18,018

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益	2,690	18,018
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△0	0
繰延ヘッジ損益	21	△266
為替換算調整勘定	△396	338
退職給付に係る調整額	△479	1,021
その他の包括利益合計	△855	1,094
包括利益	1,834	19,112
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,834	19,112
非支配株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,223	24,129	94,999	△92	143,259
当期変動額					
剰余金の配当			△3,377		△3,377
親会社株主に帰属する当期純利益			2,690		2,690
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	△686	—	△686
当期末残高	24,223	24,129	94,312	△92	142,572

	その他の包括利益累計額					純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	
当期首残高	0	—	△1,912	△2,146	△4,058	139,200
当期変動額						
剰余金の配当						△3,377
親会社株主に帰属する当期純利益						2,690
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	21	△396	△479	△855	△855
当期変動額合計	△0	21	△396	△479	△855	△1,542
当期末残高	△0	21	△2,308	△2,626	△4,914	137,658

当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,223	24,129	94,312	△92	142,572
当期変動額					
剰余金の配当			△3,377		△3,377
親会社株主に帰属する当期純利益			18,018		18,018
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	14,641	△0	14,640
当期末残高	24,223	24,129	108,953	△92	157,213

	その他の包括利益累計額					純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	△0	21	△2,308	△2,626	△4,914	137,658
当期変動額						
剰余金の配当						△3,377
親会社株主に帰属する当期純利益						18,018
自己株式の取得						△0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	△266	338	1,021	1,094	1,094
当期変動額合計	0	△266	338	1,021	1,094	15,734
当期末残高	0	△245	△1,970	△1,604	△3,820	153,393

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,940	25,631
減価償却費	14,317	17,634
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△479	△555
受取利息及び受取配当金	△298	△92
支払利息	24	54
為替差損益 (△は益)	136	△115
有形固定資産除却損	873	845
売上債権の増減額 (△は増加)	△5,081	△9,839
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△940	△5,166
仕入債務の増減額 (△は減少)	4,010	5,908
未払費用の増減額 (△は減少)	△340	1,406
その他	△1,683	△1,640
小計	14,477	34,071
利息及び配当金の受取額	299	95
利息の支払額	△22	△53
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△2,058	△311
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,696	33,801
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△1,123	△835
定期預金の払戻による収入	1,423	982
有形固定資産の取得による支出	△34,985	△31,519
無形固定資産の取得による支出	△222	△263
投資及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	△105	△71
その他	△578	△440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,591	△32,148
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	20,400	4,000
配当金の支払額	△3,377	△3,377
その他	△83	△84
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,939	538
現金及び現金同等物に係る換算差額	△314	271
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△6,269	2,462
現金及び現金同等物の期首残高	46,315	40,046
現金及び現金同等物の期末残高	40,046	42,508

(5) 連結財務諸表に関する注記事項**(継続企業の前提に関する注記)**

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 10社

※主要会社名：

SHINKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.、KOREA SHINKO MICROELECTRONICS CO., LTD.、
SHINKO ELECTRIC AMERICA, INC.

(2) 非連結子会社の名称

非連結子会社 SHINKO MICROELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日

12月末 2社

3月末 8社

12月末日決算会社は、12月末日決算により連結しております。

連結決算日の不一致による差異に重要なものがある場合には連結決算上調整を行うこととしております。

3. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

その他有価証券

(イ) 時価のあるもの……時価法 (評価差額は全部純資産直入法)

(ロ) 時価のないもの……移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

③ たな卸資産

総平均法および先入先出法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 (リース資産を除く)

主に定率法によっております。ただし、当社および国内連結子会社については、1998年4月1日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く。) ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金

当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益および費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) 消費税等の会計処理方法……税抜方式

(セグメント情報)

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、半導体パッケージの開発・製造・販売を主な事業内容としており、製品の種類や特性によって分類された事業区分に基づき、国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、当該事業区分を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「プラスチックパッケージ」および「メタルパッケージ」の2つを報告セグメントとしております。

「プラスチックパッケージ」は、プラスチック・ラミネート・パッケージ等の製造・販売およびICの組立・販売を行っております。「メタルパッケージ」は、半導体用リードフレーム、半導体用ガラス端子およびセラミック静電チャック等の製造・販売を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

セグメント間の売上高は、主に第三者間取引価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2 (注) 4	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
外部顧客への売上高	81,568	59,867	141,435	6,896	148,332	—	148,332
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	469	469	2,691	3,161	△3,161	—
計	81,568	60,337	141,905	9,588	151,493	△3,161	148,332
セグメント利益または損 失(△)	475	5,089	5,565	△489	5,075	△261	4,813
その他の項目							
減価償却費	8,653	4,978	13,631	685	14,317	—	14,317
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	4,036	3,082	7,119	317	7,437	7,816	15,253

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。

2. セグメント利益または損失の調整額△261百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

3. セグメント利益または損失は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

4. 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額7,816百万円は、主に全社共通部門における投資額であります。

5. セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2 (注) 4	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
外部顧客への売上高	113,333	66,402	179,735	8,324	188,059	—	188,059
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	463	463	3,374	3,838	△3,838	—
計	113,333	66,866	180,199	11,698	191,898	△3,838	188,059
セグメント利益	17,002	9,115	26,118	970	27,088	△581	26,507
その他の項目							
減価償却費	12,213	4,839	17,052	581	17,634	—	17,634
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	18,357	3,240	21,597	307	21,904	8,491	30,396

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。
2. セグメント利益の調整額△581百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
4. 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額8,491百万円は、主に全社共通部門における投資額であります。
5. セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	1,019.01円	1,135.49円
1株当たり当期純利益金額	19.92円	133.38円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	2,690	18,018
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	2,690	18,018
期中平均株式数 (千株)	135,090	135,090

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

《参考資料》



2021年4月27日
新光電気工業株式会社

2021年3月期 連結および単独決算概要

連結決算

	2020年3月期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで)	2021年3月期 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)
売上高	148,332 百万円	188,059 百万円
営業利益	3,227	23,328
経常利益	4,813	26,507
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,690	18,018
1株当たり当期純利益	19円92銭	133円38銭
設備投資額*	15,031	30,133
減価償却費*	14,030	17,364
研究開発費	2,849	2,981
為替レート(1米ドル)	107円	105円

* 無形固定資産を除く

単独決算

売上高	142,823 百万円	180,412 百万円
営業利益	3,610	22,235
経常利益	5,547	26,115
当期純利益	3,519	17,905
1株当たり当期純利益	26円5銭	132円55銭
1株当たり配当金	25円	30円

《参考資料》

セグメント別売上高 (連結)

(単位：百万円)

セグメント	2020年3月期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで)		2021年3月期 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)		増減率
		構成比		構成比	
		%		%	%
プラスチックパッケージ	81,568	(55.0)	113,333	(60.3)	38.9
メタルパッケージ	59,867	(40.4)	66,402	(35.3)	10.9
その他の	6,896	(4.6)	8,324	(4.4)	20.7
合計	148,332	(100.0)	188,059	(100.0)	26.8

部門別売上高 (連結)

(単位：百万円)

部門	2020年3月期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで)		2021年3月期 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)		増減率
		構成比		構成比	
		%		%	%
ICリードフレーム	31,154	(21.0)	33,418	(17.8)	7.3
ICパッケージ	92,371	(62.3)	123,135	(65.5)	33.3
気密部品	23,955	(16.1)	31,392	(16.7)	31.0
その他の	851	(0.6)	112	(0.0)	△86.8
合計	148,332	(100.0)	188,059	(100.0)	26.8